STANDARDLAGENAUFBAU HDI

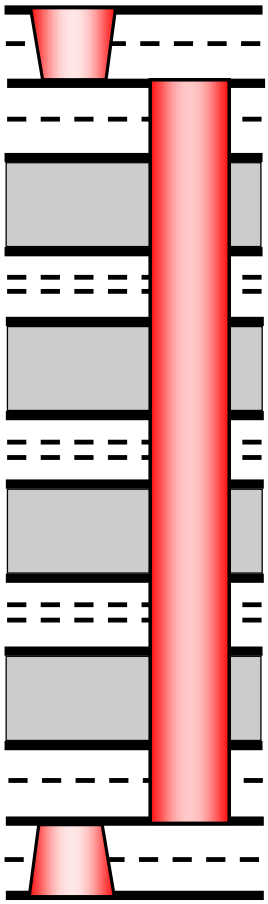
HDI12_1+10b+1_1,45_17.5

12 - Lagen

Kerne: 0,15 mm Cu 17.5/17.5 µm

WE-Artikel Nr.:	**1 + 10B + 1**
KUNDE:	

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	60	
2	VSK1		Folie	9 µm		30	
					1 x 1080	66	
3	2			17.5 µm		16	
			0,150 mm			150	
4	3			17.5 µm		16	
					2 x 1080	134	
5	4			17.5 µm		16	
			0,150 mm			150	
6	5			17.5 µm		16	
					2 x 1080	134	
7	6			17.5 µm		16	
			0,150 mm			150	
8	7			17.5 µm		16	
					2 x 1080	134	
9	8			17.5 µm		16	
			0,150 mm			150	
10	9			17.5 µm		16	
					1 x 1080	66	
11	RSK1			9 µm		30	
					1 x 1080	60	
12	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	
			1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm				
					Gesamtdicke Material:	1466	
			Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)				

MATERIALDICKE:	**1,45**	+/-	0,11	mm			Datum: / Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,54	+/-	0,14	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,60	+/-	0,16	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
29.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R.Schönholz	00	11+